

产品数据表

WS-364

互联（用于BGA植球和板级装联）助焊剂

优点

- 易清洗，残留物采用温水即可去除
- 既可用于探针转移工艺，也可用于模版印刷工艺
- 保证BGA植球的高良率
- 不含卤化物，助焊性好
- 宽松的工艺窗口
- 适用有铅和无铅工艺

介绍

WS-364互联助焊剂是一种高粘度的膏状助焊剂，用于BGA植球和板级装联，也可用于其它需要具有良好水洗性的助焊剂的工艺中。

产品属性

助焊剂类型:	ORMO
颜色:	浅黄色至浅棕色
模板寿命:	在室温下>8 小时
贮存寿命:	6 个月
SIR (表面绝缘电阻) (欧姆):	清洗后>10 ⁹ , 合格(I-STD-004)
标准粘度:	
Malcom	450-650poise@10RPM
Brookfield	850kcps,5RPM

包装

WS-364可以采用SEMCO管筒、100克罐装或10-150克注射器方式包装，也可提供其他用户特殊要求的包装方式。

清洗

在室温下，即可用去离子水或清洗剂清洗。
压力大于60psi(414kPa)时清洗1分钟或更长
压力小于30psi(270kPa)时清洗2分钟或更长

回流

在空气或氮气中，峰值温度小于260°C

储存

注射器和管筒应尖端朝下储存在0-25°C
使用前需在室温下解冻4小时

所有资料均仅供参考。不得用作收到产品之规格。



技术支持

钢泰有限公司的工程师具有丰富的国际项目经验，精通材料科学及其在电子与半导体行业中的应用，可提供焊料属性、合金兼容性等深入的技术协助和预成形焊料、焊线、焊带和焊膏等产品选择方面的专家建议。对所有技术咨询都将作出快速反应，并在24小时内给予答复。

材料安全数据表

本产品的材料安全数据表 (MSDS) 可上网下载，网址为 <http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>

本产品数据表仅作为一般信息提供。它不可作为，也不应被解释为是钢泰公司对该产品的质量或担保，产品质量保证仅在已售出产品的相

应包装和发票中，并只限于对应于此包装和发票的产品。

表格编号: 97874(SC A4) R3

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
china@indium.com
中国 +86 (0)512 628 34900
新加坡 +65 6268 8678
美国 +44 (0) 1908 580400
美国 +1 315 853 4900



经
ISO 9001
注册